



tesa® HAF 8414

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



HAF ฟิล์มติดด้วยการกระตุ้นด้วยความร้อน สามารถนำไฟฟ้าได้ในแกน z สีขุ่น หนา 40 ไมครอน

Product Description

tesa® HAF 8414 เป็นฟิล์มกาวกระตุ้นด้วยความร้อน โปร่งแสง ประกอบด้วยอนุภาคที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

คุณสมบัติพิเศษ:

- การยึดติดโมดูลชิพและการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในขั้นตอนเดียว
- สามารถใช้งานได้ดีกับสายการผลิตฝังชิพทั่วไป
- เหมาะสำหรับ PVC, ABS, PET และ PC การ์ด (DI)
- เหมาะกับพื้นผิว silver ink (RFID)

เส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐานของอนุภาค: 40 ไมครอน

การใช้งาน

tesa® HAF 8414 ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่มีความเสถียรและการเชื่อมติดที่ทนทาน การใช้งานหลักคือการฝังชิพในการ์ดแบบ Dual Interface (DI) และ strap attachment สำหรับ RFID tag

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|--------------------|-------------|
| • Type of liner | glassine | • Type of adhesive | copolyamide |
| • Backing material | none | • Color | โปร่งแสง |

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทางเทคนิค:

โปรดทราบว่าค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องจักร รวมทั้งวัสดุที่ใช้สำหรับตัวการ์ด วัสดุ antenna ชิพโมดูลและรวมถึงข้อกำหนดของลูกค้า เวลาการติดขึ้นอยู่กับการส่งผ่านความร้อนของพื้นผิววัสดุที่ใช้ นอกจากนี้ เราขอแนะนำขั้นตอนการทำให้เย็นตัวลงโดยตรงหลังจากขั้นตอนการติด ควรใช้แรงกดจนอุณหภูมิฟิล์มลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิที่ทำให้อ่อนตัว (ประมาณ 110 °C)

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นของเครื่อง

1. การเคลือบติดเบื้องต้น:

ช่วงการติดเบื้องต้น เทปกาวได้รับการเคลือบบนสายพานโมดูล การเคลือบที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ HAF 8414 เพื่อให้แน่ใจในการยึดเกาะที่ดีและค่าการนำไฟฟ้าที่ดีภายในขั้นตอนสุดท้าย

การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ 130 - 150 °C
- แรงกดทับ 1.5 - 3 บาร์

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=08414>



tesa® HAF 8414

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เวลา 1 - 2.5 ม./นาที.

2. การติดตัวนำไฟฟ้า:

ระหว่างการฝังโมดูล โมดูลที่ถูกติดเทปไว้เบื้องต้นจะถูก die-cut

จากสายพานโมดูลและถูกวางเข้าไปในหลุมของบัตรและติดอย่างถาวรเข้ากับตัวบัตรโดยความร้อนและแรงกด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ implanting line ซึ่งสามารถใช้วิธีการกดทับชั้นตอนเดียวหรือหลายชั้นตอน ปัจจุบันเครื่องฝังส่วนใหญ่ใช้แรงกดด้วยความร้อนแบบหลายชั้นตอน

การตั้งค่าเครื่อง - ชั้นตอนเดียว:

- อุณหภูมิ 160 – 220 °C
- แรงกด 65 - 130 N/โมดูล
- เวลา 1.5 วินาที

การแบบกดทับหลายครั้ง (การกดอัดด้วยความร้อน 2 ครั้งหรือมากกว่า) - การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ 180 – 220 °C
- แรงกด 65 - 130N/โมดูล
- เวลา 2 x 0,7 วินาที / 3 x 0.5 วินาที

¹อุณหภูมิตามที่วัดภายในเครื่องกดอัดด้วยความร้อน มีแนะนำการตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันสำหรับวัสดุบัตรที่แตกต่างกัน ดังนี้:

PVC 180 – 190 °C

ABS 180 – 190 °C

PET 190 – 200 °C

PC 200 – 220 °C

เพื่อการติดที่แข็งแรงสูงสุด พื้นผิวจะต้องสะอาดและแห้ง สภาวะการเก็บรักษาเป็นไปตามมาตรฐานอายุการใช้งาน tesa® HAF

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=08414>